证券代码：603061　　　　　　　　　证券简称：金海通

天津金海通半导体设备股份有限公司 2026年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是　√否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	399,958,957.74	129.62	1,000,672,521.23	107.78
利润总额	170,976,735.11	224.05	368,344,896.40	165.84
归属于上市公司股东的净利润	152,569,474.34	211.52	323,744,112.56	159.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	151,797,769.38	218.46	320,350,888.60	163.71
经营活动产生的现金流量净额	187,930,072.49	463.10	245,747,434.93	391.98
基本每股收益(元/股)	1.80	210.34	3.82	156.38
稀释每股收益(元/股)	1.79	208.62	3.82	156.38
加权平均净资产收益率(%)	7.82	增加4.48个百分点	17.77	增加8.82个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	2,877,060,604.30	2,149,652,155.84		33.84
归属于上市公司股东的所有者权益	1,960,960,387.18	1,614,293,008.86		21.47

注：1、“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

2、2026年，公司实施了2025年度利润分配及资本公积金转增股本方案，以资本公积金向全体股东每10股转增4.5股，根据《企业会计准则第34号——每股收益》的规定，调整后2025年前三季度基本每股收益（年初至报告期末）由2.16元调整为1.49元，稀释每股收益（年初至报告期末）由2.16元调整为1.49元，基本每股收益（本报告期）由0.84元调整为0.58元，稀释每股收益（本报告期）由0.84元调整为0.58元。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用　□不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分		4,059.06	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外		6,390.62	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	907,579.51	3,955,647.19	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
委托他人投资或管理资产的损益			
对外委托贷款取得的损益			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
非货币性资产交换损益			
债务重组损益			
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等			
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响			
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用			
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
交易价格显失公允的交易产生的收益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	61.44	31,261.17	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减：所得税影响额	135,935.99	604,134.08	
少数股东权益影响额（税后）			
合计	771,704.96	3,393,223.96	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用　√不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用　□不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入_本报告期	129.62	受益于AI、高性能计算、新能源汽车等下游拉动，半导体封测设备行业需求增长，叠加公司海外布局成效显现，境外订单增加，测试分选机产品销量增长所致。
营业收入_年初至报告期末	107.78	
利润总额_本报告期	224.05	
利润总额_年初至报告期末	165.84	
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	211.52	
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	159.03	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	218.46	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	163.71	
经营活动产生的现金流量净额_本报告期	463.10	销售商品收到的现金增加所致。
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	391.98	
基本每股收益(元/股)_本报告期	210.34	受益于AI、高性能计算、新能源汽车等下游拉动，半导体封测设备行业需求增长，叠加公司海外布局成效显现，境外订单增加，测试分选机产品销量增长所致。
基本每股收益(元/股)_年初至报告期末	156.38	
稀释每股收益(元/股)_本报告期	208.62	
稀释每股收益(元/股)_年初至报告期末	156.38	
总资产	33.84	公司销售增长导致应收款项和存货增长以及固定资产增加所致。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	22,276	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		不适用		
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
崔学峰	境内自然人	12,341,141	14.19	0	质押	3,697,500
龙波	境内自然人	7,749,012	8.91	0	质押	768,500
香港中央结算有限公司	境外法人	6,531,576	7.51	0	无	0
南通华泓投资有限公司	境内非国有法人	5,161,111	5.93	0	无	0
宁波旭诺创业投资基金管理合伙企业（有限合伙）	其他	4,349,900	5.00	0	无	0
上海金浦新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）	其他	2,876,558	3.31	0	无	0
天津金海通半导体设备股份有限公司－2025年员工持股计划	其他	2,515,417	2.89	0	无	0
钟格	境内自然人	1,509,000	1.73	0	无	0
广发证券股份有限公司－国泰中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金	其他	1,314,815	1.51	0	无	0
中信银行股份有限公司－永赢睿信混合型证券投资基金	其他	1,097,525	1.26	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
崔学峰	12,341,141	人民币普通股	12,341,141
龙波	7,749,012	人民币普通股	7,749,012
香港中央结算有限公司	6,531,576	人民币普通股	6,531,576
南通华泓投资有限公司	5,161,111	人民币普通股	5,161,111
宁波旭诺创业投资基金管理合伙企业（有限合伙）	4,349,900	人民币普通股	4,349,900
上海金浦新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）	2,876,558	人民币普通股	2,876,558
天津金海通半导体设备股份有限公司－2025年员工持股计划	2,515,417	人民币普通股	2,515,417
钟格	1,509,000	人民币普通股	1,509,000
广发证券股份有限公司－国泰中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金	1,314,815	人民币普通股	1,314,815
中信银行股份有限公司－永赢睿信混合型证券投资基金	1,097,525	人民币普通股	1,097,525
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、崔学峰、龙波为公司的控股股东、实际控制人，崔学峰与龙波为一致行动人； 2、除此之外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于一致行动人关系。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	不适用		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用　√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用　√不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用　√不适用

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用　√不适用

（二）财务报表

合并资产负债表

2026年9月30日

编制单位：天津金海通半导体设备股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2026年9月30日	2025年12月31日
流动资产：		
货币资金	394,805,358.68	423,263,601.76
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	192,198,775.71	128,674,123.83
衍生金融资产		
应收票据	27,103,954.00	26,618,469.92
应收账款	858,521,113.20	521,410,060.59
应收款项融资	36,992,759.46	52,938,502.09
预付款项	7,005,010.61	1,764,632.25
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	937,596.95	1,302,943.86
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	605,099,861.82	412,640,587.85
其中：数据资源		
合同资产	7,255,233.75	2,938,671.25
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	42,616,761.46	16,783,041.52
流动资产合计	2,172,536,425.64	1,588,334,634.92
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	30,097,731.00	31,727,518.77
其他权益工具投资	10,000,000.00	10,000,000.00
其他非流动金融资产	64,994,380.00	49,994,380.00
投资性房地产		
固定资产	316,244,238.72	76,888,973.41
在建工程	65,685,272.16	217,394,168.95
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	9,719,316.56	15,354,302.87
无形资产	144,998,609.50	95,410,212.31
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	19,974,716.81	19,095,675.93
递延所得税资产	25,151,263.02	30,905,585.86
其他非流动资产	17,658,650.89	14,546,702.82
非流动资产合计	704,524,178.66	561,317,520.92
资产总计	2,877,060,604.30	2,149,652,155.84
流动负债：		
短期借款	15,051,996.21	19,882,694.72
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	370,115,463.40	141,557,672.12
应付账款	363,049,719.84	257,797,981.01
预收款项		
合同负债	21,014,337.45	8,029,325.90
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	17,201,618.19	17,593,206.56
应交税费	24,193,787.71	17,132,300.40
其他应付款	28,256,167.00	12,136,798.78
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	7,578,630.77	7,724,714.60
其他流动负债	28,150,794.95	10,180,323.17
流动负债合计	874,612,515.52	492,035,017.26
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	3,137,701.60	8,543,629.72
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	5,850,000.00	2,668,500.00
递延收益	32,500,000.00	32,112,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	41,487,701.60	43,324,129.72
负债合计	916,100,217.12	535,359,146.98
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	87,000,000.00	60,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	933,889,578.95	913,289,420.01
减：库存股		
其他综合收益	1,675,650.80	3,552,543.98
专项储备		
盈余公积	32,927,255.05	32,927,255.05
一般风险准备		
未分配利润	905,467,902.38	604,523,789.82
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,960,960,387.18	1,614,293,008.86
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	1,960,960,387.18	1,614,293,008.86
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,877,060,604.30	2,149,652,155.84

公司负责人：崔学峰　　主管会计工作负责人：黄洁　　会计机构负责人：黄徐霞

合并利润表

2026年1—9月

编制单位：天津金海通半导体设备股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2026年前三季度（1-9月）	2025年前三季度（1-9月）
一、营业总收入	1,000,672,521.23	481,595,739.50
其中：营业收入	1,000,672,521.23	481,595,739.50
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	635,365,005.36	329,615,324.17
其中：营业成本	466,805,542.82	231,403,678.15
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	5,738,993.32	3,677,353.51
销售费用	54,884,277.45	26,227,070.37
管理费用	47,336,653.86	32,219,964.63
研发费用	52,300,886.52	35,650,324.42
财务费用	8,298,651.39	436,933.09
其中：利息费用	695,506.77	820,747.35
利息收入	1,355,478.28	2,329,865.81
加：其他收益	21,863,725.16	10,349,707.61
投资收益（损失以“-”号填列）	955,365.21	2,386,579.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,629,787.77	-1,472,524.17
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,370,494.21	49,170.22
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-15,075,321.62	-23,481,978.15
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-6,112,202.66	-2,670,716.20
资产处置收益（损失以“-”号填列）	22,976.40	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	368,332,552.57	138,613,178.24
加：营业外收入	40,457.65	30,119.86
减：营业外支出	28,113.82	82,885.84
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	368,344,896.40	138,560,412.26
减：所得税费用	44,600,783.84	13,579,153.60
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	323,744,112.56	124,981,258.66
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	323,744,112.56	124,981,258.66
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	323,744,112.56	124,981,258.66
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		
六、其他综合收益的税后净额	-1,876,893.18	-135,688.70
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,876,893.18	-135,688.70
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动		
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
（5）其他		
2.将重分类进损益的其他综合收益	-1,876,893.18	-135,688.70
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		
（2）其他债权投资公允价值变动		
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（4）其他债权投资信用减值准备		
（5）现金流量套期储备		
（6）外币财务报表折算差额	-1,876,893.18	-135,688.70
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	321,867,219.38	124,845,569.96
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	321,867,219.38	124,845,569.96
（二）归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	3.82	1.49
（二）稀释每股收益(元/股)	3.82	1.49

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：崔学峰　　主管会计工作负责人：黄洁　　会计机构负责人：黄徐霞

合并现金流量表

2026年1—9月

编制单位：天津金海通半导体设备股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2026年前三季度（1-9月）	2025年前三季度（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	767,345,926.82	323,160,100.09
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	29,932,001.53	9,492,258.98
收到其他与经营活动有关的现金	20,870,503.28	92,158,190.52
经营活动现金流入小计	818,148,431.63	424,810,549.59
购买商品、接受劳务支付的现金	361,240,449.47	152,619,720.05
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	90,964,825.60	72,361,172.43
支付的各项税费	72,376,678.76	50,049,233.67
支付其他与经营活动有关的现金	47,819,042.87	99,829,406.13
经营活动现金流出小计	572,400,996.70	374,859,532.28
经营活动产生的现金流量净额	245,747,434.93	49,951,017.31
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,726,485,099.65	2,142,213,494.08
取得投资收益收到的现金	4,025,082.19	4,042,360.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	82,725.00	26,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	2,730,592,906.84	2,146,282,354.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	161,439,897.99	106,128,121.78
投资支付的现金	2,805,075,374.05	2,254,508,381.15
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,966,515,272.04	2,360,636,502.93
投资活动产生的现金流量净额	-235,922,365.20	-214,354,148.19
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	14,871,555.00	19,870,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		66,351,753.10
筹资活动现金流入小计	14,871,555.00	86,221,753.10
偿还债务支付的现金	19,870,000.00	29,520,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,985,928.80	10,320,276.71
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	6,673,152.92	6,209,669.55
筹资活动现金流出小计	49,529,081.72	46,049,946.26
筹资活动产生的现金流量净额	-34,657,526.72	40,171,806.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,625,786.09	-810,964.24
五、现金及现金等价物净增加额	-28,458,243.08	-125,042,288.28
加：期初现金及现金等价物余额	423,263,601.76	531,476,364.39
六、期末现金及现金等价物余额	394,805,358.68	406,434,076.11

公司负责人：崔学峰　　主管会计工作负责人：黄洁　　会计机构负责人：黄徐霞

（三）2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用　√不适用

特此公告。

天津金海通半导体设备股份有限公司董事会

2026年10月23日

证券代码：603061　　证券简称：金海通　　公告编号：2026-078

天津金海通半导体设备股份有限公司 关于增加2026年度日常关联交易 预计额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次关联交易事项无需提交股东会审议。
- 日常关联交易对公司的影响：公司与关联方的关联交易为公司正常经营所需，有利于公司业务的发展，且由交易双方在平等、自愿的基础上协商一致达成，遵循平等、自愿、等价有偿的原则，关联交易价格公允。该类关联交易没有损害公司和股东权益的情形，公司不会因此类交易而对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2026年10月22日，天津金海通半导体设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次独立董事专门会议、第二届董事会审计委员会第二十四次会议审议通过了《关于增加2026年度日常关联交易预计额度的议案》。

公司独立董事专门会议审议后认为：本次关联交易预计符合公司业务的发展需要，交易价格公允，对公司经营活动及财务状况不存在不利影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，一致同意将以上议案提交董事会审议，关联董事应当回避表决。

公司审计委员会审议后认为：本次日常关联交易事项涉及的交易价格遵循市场化原则，没有损害公司和股东权益的情形，符合法律、法规及《天津金海通半导体设备股份有限公司章程》等有关规定，一致同意将以上议案提交董事会审议，关联董事应当回避表决。

2026年10月23日，公司第二届董事会第三十三次会议以8票同意、0票反对、0票弃权、1票回避的表决结果审议通过了《关于增加2026年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事吴华回避表决。

公司董事会审议后认为：本次日常关联交易事项符合公司日常生产经营实际情况，为公司正常经营所需，有利于公司业务的发展，且由交易双方在平等、自愿的基础上协商一致达成，遵循平等、自愿、等价有偿的原则，关联交易价格公允。该类关联交易没有损害公司和股东权益的情形，公司不会因此类交易而对关联方形成依赖。

本次增加2026年度日常关联交易预计额度未超过本公司最近一期经审计净资产的5%，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次关联交易事项无需提交公司股东会审议。

（二）本次增加2026年度日常关联交易预计金额和类别

根据2026年1-9月实际发生的关联交易金额，结合公司经营需要，公司拟将与通富微电子股份有限公司及其控股子公司苏州通富超威半导体有限公司、南通通富微电子有限公司、TF AMD MICROELECTRONICS (PENANG) SDN. BHD.、合肥通富微电子有限公司、通富通科（南通）微电子有限公司的关联交易预计额度增加8,000万元（从30,000万元增加至38,000万元）。本次增加后，2026年度，公司日常关联交易预计总额度从33,440万元增加至41,440万元，具体内容如下：

关联交易类别	关联方名称	2026年原预计额度（万元）	2026年内部调剂后的预计额度（万元）注2	前次拟增加预计额度（万元）	前次增加后2026年预计总额度（万元）	本次拟增加预计额度（万元）	本次增加后2026年预计总额度（万元）	2026年1-9月实际发生金额（未经审计）（万元）
向关联方销售商品	通富微电子股份有限公司	3,000	3,500	增加4,500	8,000	增加1,000	9,000	6,218.45
向关联方销售商品	苏州通富超威半导体有限公司	1,000	1,000	增加1,000	2,000	增加500	2,500	1,202.95
向关联方销售商品	南通通富微电子有限公司	4,000	3,500	增加4,000	7,500	增加500	8,000	6,046.22
向关联方销售商品	TF AMD MICROELECTRONICS (PENANG) SDN. BHD.	1,000	1,000	增加1,000	2,000	增加1,500	3,500	1,962.65
向关联方销售商品	合肥通富微电子有限公司	2,000	3,000	增加3,500	6,500	增加3,500	10,000	6,194.07
向关联方销售商品	通富通科（南通）微电子有限公司	5,000	4,000		4,000	增加1,000	5,000	2,590.16
向关联方销售商品	南通华达微电子集团股份有限公司	2,000	2,000		2,000		2,000	220.00
向关联方租赁房产	上海新朋实业股份有限公司	1,440	1,440		1,440		1,440	793.88
小计		19,440	19,440	增加14,000	33,440	增加8,000	41,440	25,228.38

注1：上述关联交易在关联交易预计总额范围内，公司及子公司可以根据实际情况在同一控制下的不同关联方之间的关联交易金额实现内部调剂，苏州通富超威半导体有限公司、南通通富微电子有限公司、TF AMD MICROELECTRONICS (PENANG) SDN. BHD.、合肥通富微电子有限公司、通富通科（南通）微电子有限公司为通富微电子股份有限公司的控股子公司，前述6家公司为同一控制下的不同关联方，关联交易金额可以内部调剂；

注2：本列为公司根据实际发生的关联交易金额并结合公司经营需要，在关联交易预计总额范围内，对在同一控制下的不同关联方之间的关联交易金额实现内部调剂后的金额；

注3：上表中，2026年1-9月实际发生金额均为含税金额；

注4：2024年12月，公司第二届董事会第十次会议及2024年第二次临时股东大会审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，预计公司2025-2027年度将继续向上海新朋实业股份有限公司租赁房产，每个年度发生不超过1,440万元的日常关联交易。

（三）2025年度日常关联交易的预计和执行情况

2024年12月，公司第二届董事会第十次会议及2024年第二次临时股东大会审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，预计2025年度将与通富微电子股份有限公司及其控股子公司苏州通富超威半导体有限公司、南通通富微电子有限公司、TF AMD MICROELECTRONICS (PENANG) SDN. BHD.、合肥通富微电子有限公司、通富通科（南通）微电子有限公司等发生总额不超过8,100万元的日常关联交易；同时，公司2025-2027年度将继续向上海新朋实业股份有限公司租赁房产，预计与上海新朋实业股份有限公司每个年度发生总额不超过1,440万元的日常关联交易。

2025年12月，公司第二届董事会第十九次会议及2025年第三次临时股东大会审议通过《关于增加2025年度日常关联交易预计额度及预计2026年度日常关联交易的议案》，同意将2025年度与通富微电子股份有限公司及其控股子公司苏州通富超威半导体有限公司、南通通富微电子有限公司、TF AMD MICROELECTRONICS (PENANG) SDN. BHD.、合肥通富微电子有限公司、通富通科（南通）微电子有限公司的关联交易预计总额度从8,100万元增加至9,600万元（增加预计总额度1,500万元），相关日常关联交易预计和执行情况详见下表：

关联交易类别	关联方名称	2025年原预计额度（万元）	2025年内部调剂后的预计额度（万元）注2	增加预计额度（万元）	增加后2025年预计额度（万元）	2025年内部调剂后的预计额度（万元）注2	2025年实际发生金额（经审计）（万元）	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联方销售商品	通富微电子股份有限公司	1,000	2,700	增加1,000	3,700	3,700	3,213.76	/
向关联方销售商品	苏州通富超威半导体有限公司	500	100		100	100	75.61	/
向关联方销售商品	南通通富微电子有限公司	3,000	1,000		1,000	1,000	684.58	/
向关联方销售商品	TF AMD MICROELECTRONICS (PENANG) SDN. BHD.	2,100	1,200		1,200	1,200	862.56	/
向关联方销售商品	合肥通富微电子有限公司	500	500		500	600	559.67	/
向关联方销售商品	通富通科（南通）微电子有限公司	1,000	2,600	增加500	3,100	3,000	2,529.15	/
向关联方租赁房产	上海新朋实业股份有限公司	1,440	1,440		1,440	1,440	1,045.61	/
小计		9,540	9,540	增加1,500	11,040	11,040	8,970.94	/

注1：上述关联交易在关联交易预计总额范围内，公司及子公司可以根据实际情况在同一控制下的不同关联方之间的关联交易金额实现内部调剂，苏州通富超威半导体有限公司、南通通富微电子有限公司、TF AMD MICROELECTRONICS (PENANG) SDN. BHD.、合肥通富微电子有限公司、通富通科（南通）微电子有限公司为通富微电子股份有限公司的控股子公司，前述6家公司为同一控制下的不同关联方，关联交易金额可以内部调剂；

注2：本列为公司根据实际发生的关联交易金额并结合公司经营需要，在关联交易预计总额范围内，对在同一控制下的不同关联方之间的关联交易金额实现内部调剂后的金额；

注3：上表中，2025年实际发生金额均为含税金额；

注4：2024年12月，公司第二届董事会第十次会议及2024年第二次临时股东大会审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，预计公司2025-2027年度将继续向上海新朋实业股份有限公司租赁房产，每个年度发生不超过1,440万元的日常关联交易。

二、关联人基本情况和关联关系

1、通富微电子股份有限公司

（1）关联人的基本情况

公司名称	通富微电子股份有限公司
统一社会信用代码	91320000608319749X
公司类型	股份有限公司(上市)
法定代表人	石磊
注册资本	151,759.6912万元
成立日期	1994年2月4日
住所及主要办公地点	南通市崇川路288号
主营业务	研究开发、生产、销售集成电路等半导体产品，提供相关的技术服务；自营和代理上述商品的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联人最近一年又一期主要财务数据如下：

项目	2025年12月31日（经审计）	2026年6月30日（未经审计）
总资产	472.66亿元	515.27亿元
净资产	154.94亿元	168.42亿元
项目	2025年度（经审计）	2026年1月-6月（未经审计）
营业收入	279.21亿元	160.41亿元
净利润	12.19亿元	17.17亿元

（2）与公司的关联关系

通富微电子股份有限公司为公司5%以上的股东南通华泓投资有限公司的控股股东南通华达微电子集团股份有限公司控制的其他公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法规要求，通富微电子股份有限公司为公司关联方。

（3）履约能力分析：通富微电子股份有限公司为依法存续且经营正常的深交所主板上市公司，财务及资信状况良好，经营稳健，前次关联交易执行情况良好，具有良好的履约能力。

2、苏州通富超威半导体有限公司

（1）关联人的基本情况

公司名称	苏州通富超威半导体有限公司
统一社会信用代码	91320594759661883L
公司类型	有限责任公司(外商投资、非独资)
法定代表人	石磊
注册资本	13,338万美元
成立日期	2004年3月26日
住所及主要办公地点	苏州工业园区苏桐路88号
主营业务	研发、生产、销售集成电路、半导体产品，提供相关的技术服务和维修服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联人最近一年又一期主要财务数据如下：

项目	2025年12月31日（经审计）	2026年6月30日（未经审计）
总资产	108.63亿元	110.18亿元
净资产	46.85亿元	50.80亿元
项目	2025年度（经审计）	2026年1月-6月（未经审计）
营业收入	79.71亿元	42.66亿元
净利润	9.93亿元	3.95亿元

（2）与公司的关联关系

通富微电子股份有限公司为公司持股5%以上的股东南通华泓投资有限公司的控股股东南通华达微电子集团股份有限公司控制的公司，苏州通富超威半导体有限公司为通富微电子股份有限公司的控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法规要求，苏州通富超威半导体有限公司为公司关联方。

（3）履约能力分析：苏州通富超威半导体有限公司为依法存续且经营正常的公司，财务及资信状况良好，经营稳健，前次关联交易执行情况良好，具有良好的履约能力。

3、南通通富微电子有限公司

（1）关联人的基本情况

公司名称	南通通富微电子有限公司
统一社会信用代码	913206910943210153
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人	石磊
注册资本	193,100万元
成立日期	2014年4月8日
住所及主要办公地点	南通市苏通科技产业园区江达路99号
主营业务	集成电路、半导体产品的生产及技术研发、技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联人最近一年又一期主要财务数据如下：

项目	2025年12月31日（经审计）	2026年6月30日（未经审计）
总资产	73.58亿元	72.92亿元
净资产	8.59亿元	9.10亿元
项目	2025年度（经审计）	2026年1月-6月（未经审计）
营业收入	26.79亿元	16.35亿元
净利润	-3.74亿元	0.51亿元

（2）与公司的关联关系

通富微电子股份有限公司为公司持股5%以上的股东南通华泓投资有限公司的控股股东南通华达微电子集团股份有限公司控制的公司，南通通富微电子有限公司为通富微电子股份有限公司的控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法规要求，南通通富微电子有限公司为公司关联方。

（3）履约能力分析：南通通富微电子有限公司为依法存续且经营正常的公司，财务及资信状况良好，经营稳健，前次关联交易执行情况良好，具有良好的履约能力。

4、TF AMD MICROELECTRONICS (PENANG) SDN. BHD.

（1）关联人的基本情况

公司名称	TF AMD MICROELECTRONICS (PENANG) SDN. BHD.
公司类型	有限责任公司
法定代表人	石磊
注册资本	54,849.9473万林吉特
成立日期	1978年8月3日
住所及主要办公地点	Suite A, Level 9, Wawasan Open University,54, Jalan Sultan Ahmad Shah, Penang 10050 Malaysia
主营业务	从事半导体封装和测试业务

关联人最近一年又一期主要财务数据如下：

项目	2025年12月31日（经审计）	2026年6月30日（未经审计）
总资产	96.11亿元	122.82亿元
净资产	33.35亿元	34.62亿元
项目	2025年度（经审计）	2026年1月-6月（未经审计）
营业收入	94.11亿元	53.95亿元
净利润	4.59亿元	2.33亿元

（2）与公司的关联关系

通富微电子股份有限公司为公司持股5%以上的股东南通华泓投资有限公司的控股股东南通华达微电子集团股份有限公司控制的公司，TF AMD MICROELECTRONICS (PENANG) SDN. BHD.为通富微电子股份有限公司的控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法规要求，TF AMD MICROELECTRONICS (PENANG) SDN. BHD.为公司关联方。

（3）履约能力分析：TF AMD MICROELECTRONICS (PENANG) SDN. BHD.为依法存续且经营正常的公司，财务及资信状况良好，经营稳健，前次关联交易执行情况良好，具有良好的履约能力。

5、合肥通富微电子有限公司

（1）关联人的基本情况

公司名称	合肥通富微电子有限公司
统一社会信用代码	9134010032803903XA
公司类型	其他有限责任公司
法定代表人	石磊
注册资本	250,000万元
成立日期	2015年1月23日
住所及主要办公地点	安徽省合肥市经济技术开发区卫星路578号
主营业务	集成电路、半导体产品的生产及技术研发、技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联人最近一年又一期主要财务数据如下：

项目	2025年12月31日（经审计）	2026年6月30日（未经审计）
总资产	22.93亿元	25.20亿元
净资产	6.72亿元	7.37亿元
项目	2025年度（经审计）	2026年1月-6月（未经审计）
营业收入	12.17亿元	7.38亿元
净利润	0.01亿元	0.65亿元

（2）与公司的关联关系

通富微电子股份有限公司为公司持股5%以上的股东南通华泓投资有限公司的控股股东南通华达微电子集团股份有限公司控制的公司，合肥通富微电子有限公司为通富微电子股份有限公司的控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法规要求，合肥通富微电子有限公司为公司关联方。

（3）履约能力分析：合肥通富微电子有限公司为依法存续且经营正常的公司，财务及资信状况良好，经营稳健，前次关联交易执行情况良好，具有良好的履约能力。

6、通富通科（南通）微电子有限公司

（1）关联人的基本情况

公司名称	通富通科（南通）微电子有限公司
统一社会信用代码	91320600MA279FWW2L
公司类型	有限责任公司
法定代表人	石磊
注册资本	80,000万元
成立日期	2021年10月22日
住所及主要办公地点	南通市通京大道226号11幢
主营业务	一般项目：集成电路设计；集成电路制造；集成电路销售；集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

关联人最近一年又一期主要财务数据如下：

项目	2025年12月31日（经审计）	2026年6月30日（未经审计）
总资产	40.42亿元	49.65亿元
净资产	3.49亿元	4.26亿元
项目	2025年度（经审计）	2026年1月-6月（未经审计）
营业收入	15.98亿元	11.39亿元
净利润	-0.80亿元	0.77亿元

（2）与公司的关联关系

通富微电子股份有限公司为公司持股5%以上的股东南通华泓投资有限公司的控股股东南通华达微电子集团股份有限公司控制的公司，通富通科（南通）微电子有限公司为通富微电子股份有限公司的控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法规要求，通富通科（南通）微电子有限公司为公司关联方。

（3）履约能力分析：通富通科（南通）微电子有限公司为依法存续且经营正常的公司，财务及资信状况良好，经营稳健，前次关联交易执行情况良好，具有良好的履约能力。

三、日常关联交易主要内容

通富微电子股份有限公司及其控股子公司是公司的重要客户，公司主要为其供应半导体测试分选机及相关备品备件。产品价格遵循市场化原则，由协议双方根据市场情况协商确定。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方的关联交易为公司正常经营所需，有利于公司业务的发展，且由交易双方在平等、自愿的基础上协商一致达成，遵循平等、自愿、等价有偿的原则，关联交易价格公允。本次增加2026年度日常关联交易预计额度事项没有损害公司和股东权益的情形，公司不会因此类交易而对关联方形成依赖。

特此公告。

天津金海通半导体设备股份有限公司董事会

2026年10月24日

证券代码：603061　　证券简称：金海通　　公告编号：2026-079

天津金海通半导体设备股份有限公司 关于2026年1-9月计提信用 及资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

天津金海通半导体设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月22日召开第二届董事会审计委员会第二十四次会议、于2026年10月23日召开第二届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于2026年1-9月计提信用及资产减值准备的议案》，同意公司依据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，对截至2026年9月30日的各项资产计提信用及资产减值准备。现将本次计提信用及资产减值准备情况公告如下：

一、信用减值及资产减值准备计提情况

根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为真实、准确、公允地反映公司财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内各公司所属存在减值迹象的资产进行了减值测试，对合并报表范围内可能发生减值损失的有关资产计提相应减值准备。公司本次计提各项信用及资产减值准备合计21,187,524.28元，具体情况如下：

单位：元

序号	项目	2026年1-9月计提减值准备金额	备注
1	信用减值准备	15,075,321.62	应收票据坏账准备、应收账款坏账准备、其他应收款坏账准备
2	资产减值准备	6,112,202.66	存货跌价准备、合同资产减值准备
合计		21,187,524.28	

二、计提信用减值准备及资产减值准备的依据及说明

（一）计提信用减值准备的依据及说明

根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的规定，对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款，其他应收款、应收款项融资等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资、单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。经测试，2026年1-9月公司计提信用减值准备15,075,321.62元。

（二）计提资产减值准备的依据及说明

1、存货跌价准备

根据《企业会计准则第1号——存货》的规定，资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备，计入当期损益。在确定存货的可变现净值时，以取得的可靠证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

公司对截至2026年9月30日的存货项目进行了减值测试，2026年1-9月计提存货跌价准备5,721,960.16元。

2、合同资产减值准备

根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的规定，公司对截至2026年9月30日的合同资产进行了减值测试，2026年1-9月公司计提合同资产减值准备390,242.50元。

3、固定资产、无形资产等长期资产减值

公司对存在减值迹象的固定资产、无形资产等长期资产，根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定其可回收金额，并以单项资产按其期末成本与可收回金额孰低原则计提减值准备并计入当期损益。公司对截至2026年9月30日的固定资产、无形资产等长期资产进行了全面的清查和减值测试，固定资产、无形资产等长期资产无需计提减值准备。

三、对公司的影响

2026年1-9月，公司计提信用及资产减值准备合计21,187,524.28元，预计将减少公司2026年1-9月利润总额21,187,524.28元。公司2026年1-9月计提的减值准备未经会计师事务所审计。本次计提信用及资产减值准备符合《企业会计准则》及会计政策要求，能够真实、客观地反映公司截至2026年9月30日的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会影响公司正常经营，不存在损害公司和全体股东利益的情形，特别是中小股东利益的情况。

四、本次计提信用及资产减值准备的审议程序

本次计提信用及资产减值准备事项已经公司第二届董事会审计委员会第二十四次会议审议通过，并经公司第二届董事会第三十三次会议审议通过。

（一）董事会审计委员会意见

审计委员会认为：本次计提信用及资产减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情况。同意将该议案提交董事会审议。

（二）董事会意见

公司董事会认为：公司依据实际情况进行信用及资产减值准备计提，符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公允地反映了公司的资产状况，同意公司本次计提信用及资产减值准备。

特此公告。

天津金海通半导体设备股份有限公司董事会

2026年10月24日